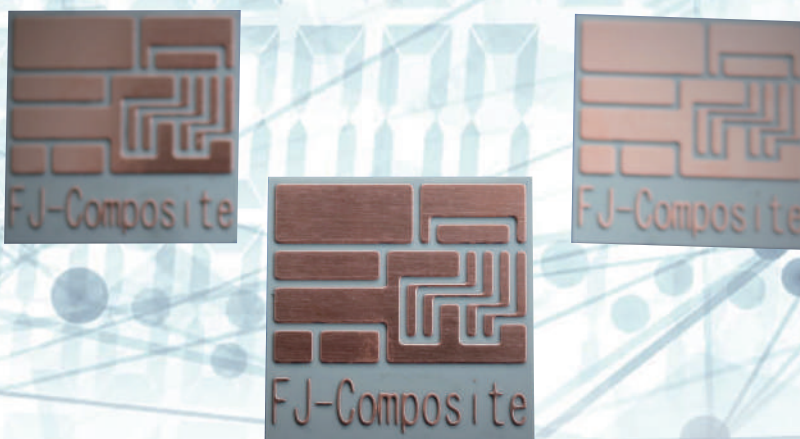


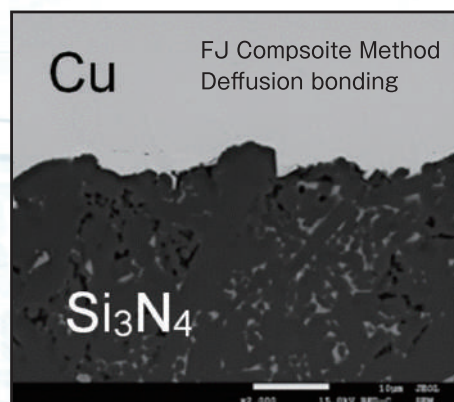
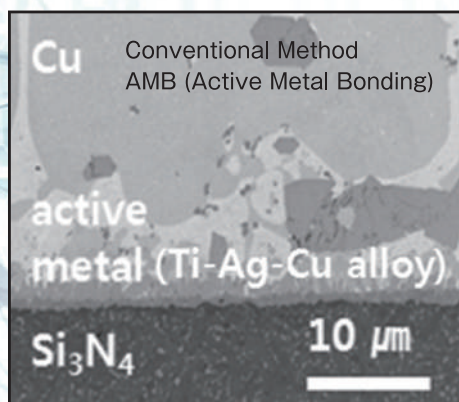
セラミックス絶縁回路基板 (S-DBC)

SiN、AlNなどのセラミックスを用いた
絶縁回路基板を作製いたしました。



FJC製 セラミックス絶縁回路基板 (S-DBC) の特徴

- SiN, AlN, BeO, Al₂O₃ などのセラミックスを用いた回路基板をご提供
- 接合はS-DBC (Sputtering Diffusion Bonding Copper)による新技術
- 従来法 (AMB:Active Metal Bonding)に比べ、強固な接合力により、厚銅 (1mm) に対応
- 接合界面に合金層が無く、高い熱伝導率を実現
- -40~170℃熱サイクル試験に合格



SiN と Cu の接合界面の顕微鏡写真 (S-DBC 法では合金層が観察されない。)



ものづくり日本大賞

FJ Composite

〒066-0009 北海道千歳市柏台南 2 丁目 2-3 TEL 0123-29-7034 FAX 0123-29-7035

<https://www.fj-composite.com>

